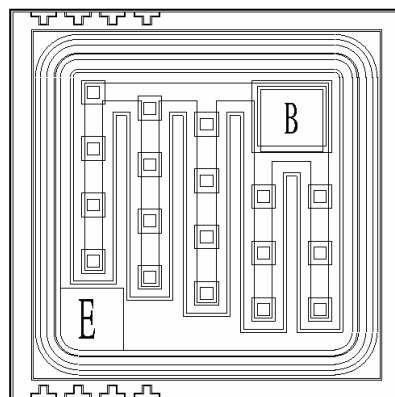




芯片简介

- 芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
- 芯片代码：A065BJ-00
- 芯片厚度：240 ± 20μm
- 管芯尺寸：650 × 650μm²
- 焊位尺寸：B 极 105×105μm² ; E 极 105×105μm²
- 电极金属：铝
- 背面金属：金
- 典型封装：S8550 , H8550L

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

- T_{stg}——贮存温度..... -55~150
- T_j——结温..... 150
- P_C——集电极耗散功率..... 1W
- V_{CBO}——集电极—基极电压..... -40V
- V_{CEO}——集电极—发射极电压..... -25V
- V_{EBO}——发射极—基极电压..... -6V
- I_C——集电极电流..... -1.2A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{CB} =-35V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{EB} =-6V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	85		500		V _{CE} =-1V, I _C =-100mA
		40				V _{CE} =-1V, I _C =-800mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压			-1.0	V	V _{CE} =-1V, I _C =-10mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		0.2	-0.5	V	I _C =-800mA, I _B =-80mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	I _C =-800mA, I _B =-80mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	25			V	I _C =-2mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =-100μA, I _C =0
f _T	特征频率	100			MHz	V _{CE} =-10V, I _C =-50mA